

폴리미래, PP 4개 그레이드 개발

부직포용 3개에 고강도 섬유용 1개 ... 스펀본드 점유율 50% 유지

폴리미래(대표 조진욱)는 10월말 기존의 PP(Polypropylene)보다 물성과 가공성이 향상된 HP562S, HP563S, HP562T 스펀본드 제품 3가지와 고강도 스테이플 파이버용 제품인 HP563N을 신규 개발했다.

폴리미래 관계자는 “폴리미래가 신규 스펀본드 제품 3가지를 공급함에 따라 50%의 시장점유율을 가지고 있는 스펀본드 시장에서 확고한 위치를 차지하게 됐다”고 밝혔다.

폴리미래는 Basell 기술을 적용해 7월부터 신제품을 선보였으며, 고객반응을 통한 시장진입 가능성의 타진이 끝난 10월말 본격적으로 상품화에 돌입했다.

폴리미래가 개발한 스펀본드용 제품은 부직포의 CD 강도가 기존 제품에 비해 5-15% 정도 향상됐으며, 가공 중에 발생하는 Fume이 현저히 줄어 단사(절사) 현상이 거의 없을 뿐만 아니라 저 데니어 방사 안정성 또한 대단히 뛰어나 생산성 향상에 크게 기여하는 것으로 알려졌다.

또 토목용, 산업자재용으로 사용되는 고강도 스테이플 파이버용 제품인 HP563N을 개발해 국내 및 해외 고객들로부터 호평을 받고 있으며, 기존의 제품으로 발현하기 어려운 6.5g/denier 이상의 인장강도를 발현함으로써 최종제품의 물성이 획기적으로 향상된 제품의 제조가 가능하게 됐다.

폴리미래의 신제품 개발에 따라 국내 PP 생산기업들도 Bench Marking에 돌입할 것으로 전망되는데, Bench Marking에 약 6개월이 소요될 것으로 보여 폴리미래는 2004년 4월경까지 신제품 출시에 따른 경쟁우위를 점할 것으로 예상된다. <김동민 조사연구원>

<Chemical Journal 2003/12/04>